

提高钎焊湿润性

HIGH SOLDER G

镀镍后使用HIGH SOLDER G，只需通过浸渍处理就能提高镀镍的钎焊湿润性。

【特点】

- 提高镀镍的钎焊湿润性。
- 不会妨碍电镀的导电率。
- 具有推迟镀镍层氧化的效果。
- 只需简单的浸渍处理。

【使用方法】

- 浓度 100 ~ 200 ml/L
溶解于30℃左右的离子交换水
- 温度 常温(20~30℃)
- 时间 20~30 sec

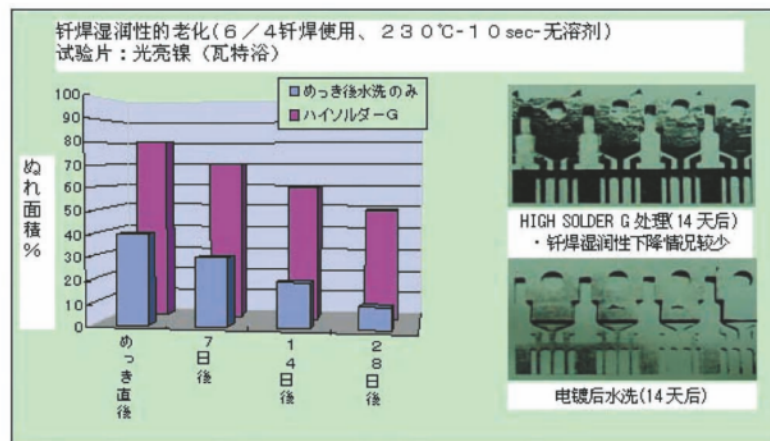
【工艺流程】

SOLDATIVE 镀镍 → 水洗 → 水洗 →
→ 水洗 → 干燥

HIGH SOLDER G 浸渍处理

* 虽然镀镍适用于无光泽、光泽、电气电镀、无电解电镀，但本社のSOLDATIVE镀镍产品的钎焊湿润性好，最为适合。

* 长期放置导致钎焊湿润性下降时，再次活性处理后可使用HIGH SOLDER G恢复其钎焊湿润性。



株式会社 清水

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主(上海)贸易有限公司
上海市徐汇区虹漕路421号65号楼5层E座
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339
Website: <http://www.shimizu.com.cn>
E-mail: shimizu@shimizu.com.cn